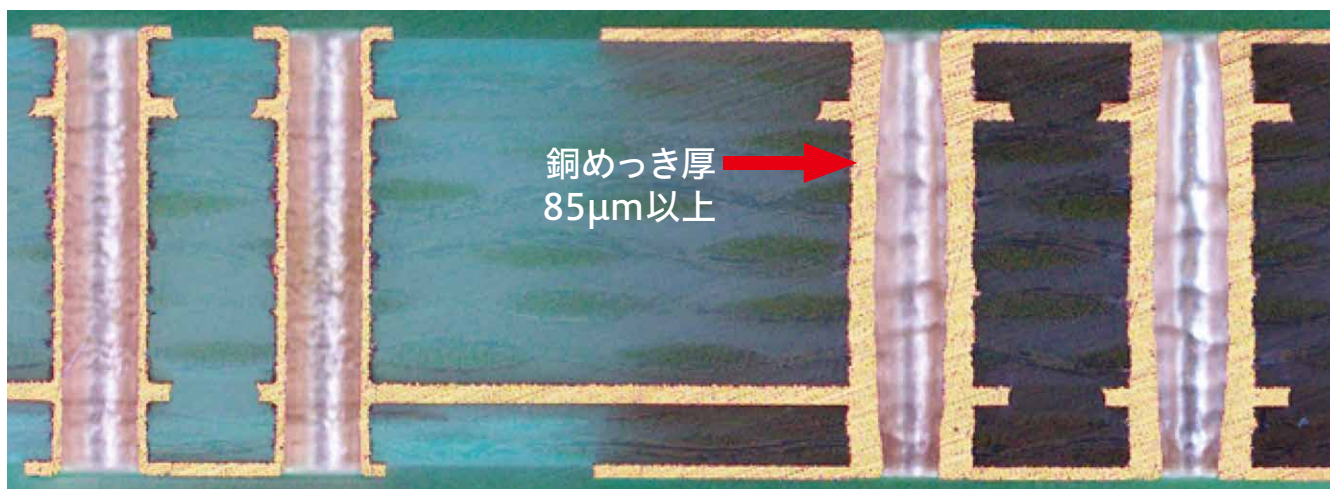


メガスルホール™

MegaTH™ technology

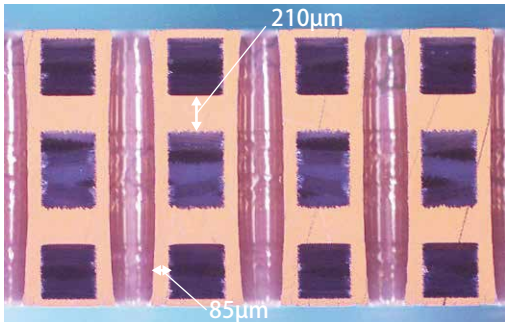
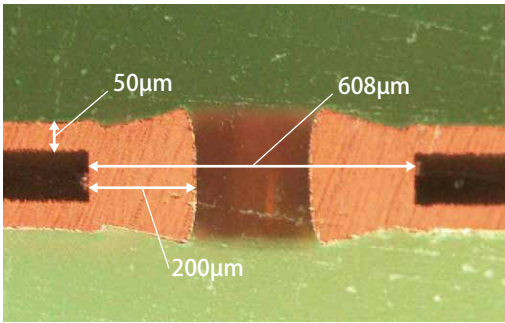
特長 Features

- ✓ 任意のスルホールに対して一般的なスルホールの数倍以上の銅めっき厚を確保。
The thickness of copper plating on any through hole is more than three times that of general through holes.
- ✓ 表裏、内層への大電流、伝熱経路を確保。
Secures a large current and heat transfer path to the front and back, inner layers.



一般TH(ドリル径φ0.3)
銅めっき厚TH穴壁25μm

MegaTH(ドリル径φ0.4)
銅めっき厚TH穴壁85μm

ラインナップ Lineup	スーパーメガスルホール Super MegaTH	メガスルホールMk.2 MegaTH Mk.2 R&D
構造 Construction		
特長 Feature	内層厚銅層との接続により放熱性と大電流対応を強化。様々な構造に対応が可能。	TH銅めっき厚200μmへのUPと薄板t0.1mmへ対応した高性能メガスルホールを開発。従来にない画期的な大電流高放熱構造への応用展開が可能。
仕様 Specification	銅めっき厚TH穴壁85μm 内層銅厚210μm	Min板厚0.1mm 銅めっき厚TH穴壁200μm ドリル径0.6mm